

Anwenderhinweise für Lotdrähte

Application Note for Cored Solder Wires

BALVER ZINN[®]
COBAR[®]

Datum / Date: 2024.01.01

Sprache / Language: Multilingual

Revision / Revision: 24.01



Wareneingang und Lagerung	Receiving and storage
<p>Beim Wareneingang ist darauf zu achten, dass die Spulen unbeschädigt sind. Das Produkt ist bei Raumtemperatur zu lagern. Das Produkt sachgemäß verwenden und die Spulen nicht werfen.</p> <p>Produktkennzeichnungen und Chargennummer nicht entfernen oder unkenntlich machen.</p>	<p>When receiving the goods, make sure that the reels are undamaged. The product must be stored at room temperature. Use the product properly and do not throw the reels.</p> <p>Do not remove or damage product labels and batch number. Make sure these remain legible.</p>
<p>BITTE NICHT:</p> <ul style="list-style-type: none"> X Unsachgemäß lagern X Werfen X Produktkennzeichnungen entfernen 	<p>DO NOT:</p> <ul style="list-style-type: none"> X Improper storage X Throw X Remove/damage labeling
Handhabung	Handling
<p>Die Temperatur der Lötspitzen sollte mindestens 100°C über der Schmelztemperatur des Lotes gewählt werden und die 400°C im normalen Lötprozess nicht übersteigen. Für bleifreie Legierungen werden Temperaturen zwischen 330 – 380°C empfohlen. Bei höheren Temperaturen nimmt der Lötspitzenverbrauch rapide zu und die optimale Arbeitstemperatur des Flussmittels wird überschritten. Dadurch kann es zu Spritzern, Aktivitätsverlust oder verkohlten, schwarzen Rückständen kommen. Um die Lötspitze zu schonen sollten möglichst milde Flussmittel (L0 nach J-STD-004) sowie eine lötpitzenschonende Legierung gewählt werden. Den LötKolben nie länger als erforderlich bei Löttemperatur eingeschaltet lassen. Schwarze, oxidierte Lötspitzen, die kein Lot mehr annehmen, mechanisch reinigen und mit frischem Lot verzinnen oder mit dem Balver Tip chemisch reinigen und dabei verzinnen. Lotreste vor jedem Arbeitsgang von der Lötspitze trocken abstreifen.</p>	<p>The temperature of the soldering tips should be selected at least 100°C above the melting temperature of the solder and should not exceed 400°C in the normal soldering process. For lead-free alloys, temperatures between 330 - 380°C are recommended. At higher temperatures, soldering tip consumption increases rapidly and the optimum working temperature of the flux might be exceeded. This can result in splattering, loss of activity or charred, black residues. To protect the soldering tip, the mildest possible flux (L0 according to J-STD-004) and an alloy that is gentle on the soldering tip should be selected. Never leave the soldering iron switched on at soldering temperature for longer than necessary. Oxidized black soldering tips that no longer accept solder should be cleaned mechanically and tinned with fresh solder or chemically cleaned with the Balver Tip and tinned with solder after cleaning. Wipe solder residues dry from the soldering tip before each work step.</p>
<p>BITTE NICHT:</p> <ul style="list-style-type: none"> X Temperaturen oberhalb 400°C wählen X Aggressive Flussmittel verwenden X Die Lötspitze unverzinnt lassen X Die Lötstation angeschaltet lassen, bei Pausen die länger als 5 Minuten dauern X Lotreste auf der Lötspitze vor dem Arbeitsgang belassen 	<p>DO NOT:</p> <ul style="list-style-type: none"> X Select temperatures above 400°C X Use aggressive flux X Leave the soldering tip untinned X Leave the soldering station switched on for pauses longer than 5 minutes X Leave solder residues on the soldering tip before the working cycle (tip cleaning before soldering)

Parameter	Flux Core	SN97C [SAC305]	SN96C [SAC385]	SN100C [®] [SnCuNi]	SN100CV [®] [SnBiCuNi]	Sn60Pb40	SN63 [Sn63Pb37]
Melting range[°C]	B2012	217 – 220	217	227	221 – 225	183 – 188	183
	2220	217 – 220	217	227	221 – 225	183 – 188	183
	3135	217 – 220	217	227	221 – 225	183 – 188	183
Min. soldering temperature [°C]	B2012	320	317	327	325	288	283
	2220	320	317	327	325	288	283
	3135	320	317	327	325	288	283
Max. soldering temperature [°C]	B2012	400	400	400	400	400	400
	2220	400	400	400	400	400	400
	3135	400	400	400	400	400	400
Recommended soldering range [°C]	B2012	330 – 370	330 – 370	330 – 380	330 – 380	290 – 350	290 – 350
	2220	330 – 370	330 – 370	330 – 380	330 – 380	290 – 350	290 – 350
	3135	330 – 370	330 – 370	330 – 380	330 – 380	290 – 350	290 – 350
Recommended soldering time [s]	B2012	1 – 2	1 – 2	1 – 2	1 – 2	1 – 3	1 – 3
	2220	1 – 2	1 – 2	1 – 2	1 – 2	1 – 3	1 – 3
	3135	1 – 2	1 – 2	1 – 2	1 – 2	1 – 3	1 – 3

Soldering recommendation

Produktreste / Verwertung

Produktreste und / oder Reaktionsprodukte sind Wertstoffe und sollten einer hochwertigen Verwertung zugeführt werden.

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen sollten einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Ursprungsinhalt (Stoff) zu behandeln. Dieses kann gem. den nationalen Rechtsvorschriften bei autorisierten Fachbetrieben oder im Rahmen der freiwilligen Rücknahme (§26 KrWG Abs. 2) durch BALVER ZINN erfolgen.

Endgeräte sind getrennt vom Hausmüll bei einer offiziellen Sammelstelle dem Recyclingkreislauf zu zuführen.

Verweis auf die Endproduktspezifischen Entsorgungsverordnungen (WEEE, Altautoverordnung...)

Wir verweisen auf das zugehörige Sicherheitsdatenblatt (SDS).

Sprechen Sie uns an.

Product leftover / Recovery

Product residues and / or reaction products are recyclable materials and should be sent for high-quality recycling.

Non-contaminated and empty packaging should be recycled.

Contaminated packaging must be treated in the same way as the original content (substance). In accordance with national legislation, this can be done by authorized specialist companies or by BALVER ZINN as part of the voluntary take-back scheme (§26 KrWG para. 2).

End devices must be disposed separately from domestic waste at an official collection point for recycling.

Reference to the end product-specific disposal regulations (WEEE, end-of-life vehicle regulations, etc.)

Please refer to the associated safety data sheet (SDS).

Please contact us.